

巻 頭 言

取締役兼執行役員
(技術統括部担当役員)

仲村 公孝



去る1月1日に発生しました「令和6年 能登半島地震」により被災されました皆様には、心よりお見舞い申しあげるとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

世界の状況はウクライナや中東での紛争が続いており、地政学リスクによるエネルギーや素材等のサプライチェーンは予断を許さない状況であります。このような背景の中、半導体サプライチェーンは再編期を迎えており、日本においてはTSMC社の熊本への誘致、国際連携を軸としたRapidus社/LSTC（技術研究組合 最先端半導体技術センター）の立ち上げ等、国内半導体のサプライチェーン強化が進んでいます。また、生成AIの加速度的な発展により、業務効率化・生産性向上にとどまらない、新しい価値を取り入れた製品やビジネスが創造されようとしています。

当社は「新しい成長に向けた挑戦のはじまり」として、昨年度より第5次中期経営計画を実行しています。その実行策の指針として①SDGsへの取り組み ②挑戦をリスペクトする組織への変革 ③“設備技術産業の雄”への挑戦 ④新しい事業領域への挑戦 を掲げております。更にこれらの指針を基本として、これまで培ってきたナレッジ・ノウハウを新たな価値・ソリューションとしてお客様に提供できるよう挑戦しております。

本号では、SDGs活動の一環として取り組んでいる「宗像ユニプロジェクト」の活動やプラントライフサイクルエンジニアリングに挑戦し続ける共同研究、さまざまな分野での利活用が進展している電流情報量診断技術やBIMプラットフォームを紹介しております。また、プラント設備の高経年化に活用される「パルス渦電流法を用いた腐食検査装置（Lyft）の紹介」を東亜非破壊検査株式会社様よりご寄稿戴いております。

是非、これらの論文・報告をご高覧頂きまして、皆様の忌憚のないご意見・ご批評を頂ければ、誠に幸甚でございます。

今後とも皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。